**LED芯片分选机-多轴复合平台（上下料组件）**

**公开招标公告**

### ****项目基本情况：****

项目编号：SCWLJCZB202403002

项目名称：LED芯片分选机-多轴复合平台招标项目

项目地点：广东省深圳市宝安区福海街道重庆路16号

项目要求：详情请见《招标书》

招标标的：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 物料名称 | 单位 | 招标数量 |
| 上下料组件 | 多轴复合平台 | 套 | 2000 |

### ****合格投标人要求:****

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，运营正常，成立时间须满1年，经营范围必须涵盖所投标产品，不接受个体工商户投标；

2、投标人不能是招标方在职员工创立、入股的公司，不能是与招标方在职员工存在利益、亲属关系的公司，不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司；

3、须有相关OEM或者ODM经验（提供案例介绍（PPT））；

4、有合法经营/生产场地，总面积不低于600平米，其中生产场地不低于300平米；须在厂内完成产品组装调试；

5、常备装配人员不低于5人；有专职品质人员（不低于2人），所有公差尺寸检验均能厂内完成。有专职统筹人员及时回复进度、交期以及售后处理情况；

6、财务状况良好；能提供增值税专用发票；

7、配合招标方进行资质预审（如技术方案评估、现场考察）；

8、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

注：投标保证金20万元 履约保证金为中标金额2%（中标后缴纳）

### ****招标文件获取****

时间：2024年3月11日 至2024年3月18日。（法定节假日除外）

获取方式及途径：下载《投标报名表》，填写完整后，以邮件形式发送至招标方联系人。

### ****投标时间/地点安排：****

1、技术方案评估文件提交开始时间：2024年3月14日8：30

2、技术方案评估文件提交截止时间：2024年3月20日18：00

3、提交投标文件开始时间:2024年4月2日8：30（北京时间）

2、提交投标文件截止时间:2024年4月8日12：00（北京时间）

3、投标文件递交地点及接收人：深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光全球智造中心2栋，肖小姐，0755-85243814/13425118970

4、预计开标时间：2024年4月8日14:00（北京时间）

5、开标地点: 广东省深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光全球智造中心

### ****对本次招标提出询问，请按以下方式联系:****

联系人1：肖小姐 0755-85243814/13425118970

邮箱地址：xiaohp110666@hanslaser.com

联系人2：陈小姐 0755-85245864/13714892077

邮箱地址：chenl127825@hanslaser.com

 大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年3月8日